

国際スマートグリッドEXPO 出展のご案内

拝啓

寒冷の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は来る3月2日から4日まで東京ビッグサイトで開催されます第1回国際スマートグリッドEXPOに出展いたします。

スマートグリッド（次世代電力網）の構築は、地球温暖化防止を目的とする新たな産業として脚光を浴びております。弊社は、最先端のはんだ付け材料を用いて、太陽光パネル実装、パワーデバイス実装、LED実装で『スマートグリッド イノベーションをサポート』をコンセプトに各種材料を展示いたします。

主な出展製品は、省エネ低温実装材料Sn-Bi系L20&23、車載用途向け高信頼性鉛フリー材料M53、パワーエレクトロニクスで良好な放熱性をお約束するNiボール入りプリフォームソルダーHQ、半導体実装での耐落下衝撃特性に優れたはんだボール用材料M61、太陽光モジュール用フラックスES-Z-15half、M705と同等以上の長期接合信頼性を実現した低銀M40、太陽光モジュール用銀ナノペースト、リフロー装置CX430 & SNR850MB、はんだ材料を応用したスプリンクラーや可溶栓、EICCに加盟した報告をいたします。

ご多用とは存じますが、ご来場賜り弊社製品をご高覧くださいます様、ご案内申し上げます。

敬具

千住金属工業株式会社
社長 長谷川 永悦

東2ホール 東9-3 で展示致します

太陽光パネル実装、パワーデバイス実装、LED実装で
『スマートグリッド イノベーションをサポート』
Support for Smart Grid Innovation
Solar Panel Mounting, Power Device Mounting, LED Mounting

半導体パッケージング展 展示製品

© 2011 SMIC